

SOD128-FL



SOD128-FL 패키지는 통신 기기의 소형화를 가능하게 하는 소형 표면 실장 패키지인 FLAT 시리즈 제품입니다. 인터커넥트 특성인 Cu 클립 구조는 와이어 본딩을 거친 제품 대비 전기적 저항은 줄이고 열 성능은 향상시킵니다.

이 패키지는 다음의 이름으로도 알려져 있습니다.

- ▶ M-Flat

Applications

FLAT 패키지는 소형 및 중형 크기의 고효율 다이오드가 사용된 애플리케이션에 적합합니다.

- ▶ Schottky Barrier Diodes (SBDs)
- ▶ Rectifier Diodes
- ▶ Zener Diodes

Reliability Qualification

엠코의 디바이스는 신뢰성이 입증된 반도체 재료로 제조됩니다.

- ▶ 모든 테스트는 $T_a = 85^\circ\text{C}/\text{Rh} = 85\%$, 16 hrs with solder dip, $T_a = 265^\circ\text{C}$, 10s 전처리 조건 포함
- ▶ 고온·고습도 방치(THS) : $T_a = 85^\circ\text{C}/\text{Rh} = 85\%$, 500 hrs
- ▶ 고온방치(HTS) : $T_a = 150^\circ\text{C}$, 500 hrs
- ▶ 압력밥솥 : $T_a = 121^\circ\text{C}/\text{Rh} = 100\%/P = 2 \text{ atm}$, 144 hrs
- ▶ 온도 사이클 : $-65\sim 150^\circ\text{C}$, 300 cycles

Test Service

엠코는 모든 Power discrete 제품에 대해 완전한 턴키 비즈니스를 제공합니다. 또한 MOSFET, 양극성 트랜지스터, IGBT, 다이오드와 레귤레이터 IC/지능형 전원 장치를 비롯한 다양한 유형의 전력 디바이스 테스트 능력을 보유하고 있습니다.

- ▶ 엠코의 Power discrete 테스트 능력 :
 - ▷ 정적 테스트(DC)
 - ▷ 동적 테스트(AC, Switching/Trr, Capacitance/Rg)
 - ▷ 파괴 테스트(Inductive load/VISUS, I Latch, Surge, Isolation/VIL)
 - ▷ 열 저항(ΔVDS , ΔmV , etc.)
- ▶ 프로그램 생성/변환
- ▶ 불량 분석
- ▶ 뛰어난 테스트/핸들링 기술
- ▶ 통합된 마킹, 육안 검사 및 테이프 및 릴 서비스

Features

- ▶ 인덕턴스와 저항 감소를 위한 Cu 커넥터 구조
- ▶ 열 성능 개선
- ▶ 턴키 테스트와 패키지 서비스
- ▶ 친환경 재료 : 무연 도금 & 무할로겐 몰드 화합물

New Developments

- ▶ 더 크고 집적도가 높은 리드프레임 스트립
- ▶ 친환경 무연 솔더 페이스트

Process Highlights

- ▶ 비도금 Bare copper 리드프레임
- ▶ 인터커넥트 : 전기적·방열 성능 개선을 위해 Cu 클립 기술 사용
- ▶ 도금 : 100% matte Sn
- ▶ 마킹 : 펜 타입 레이저

SOD128-FL

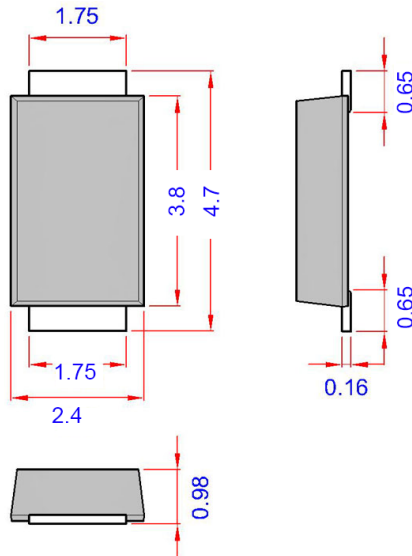
Standard Materials

- ▶ 리드프레임 : Bare copper
- ▶ 칩 어태치 : 솔더 페이스트
- ▶ 인터커넥트 : Cu 클립
- ▶ 몰드 화합물 : 무할로겐

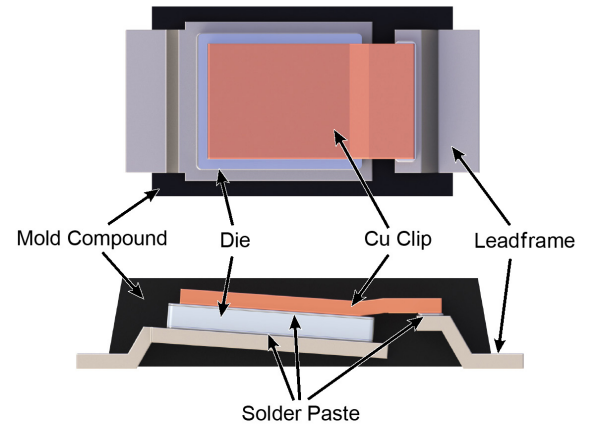
Shipping

- ▶ 테이프 및 릴 포장
 - ▷ 릴 당 3000개
 - ▷ 테이프 너비 12 mm
 - ▷ 릴 $\Phi = 180$ mm
- ▶ 바코드 패키징 라벨
- ▶ Drop Ship

Package Outline Drawing



Cross-section



자세한 내용은 amkor.com을 방문하거나 ATKQnA@amkor.co.kr로 이메일을 보내십시오.

본 문서의 모든 콘텐츠는 저작권법에 따라 무단복제 및 배포를 금지하며, 제공된 정보의 정확성을 보장하지는 않습니다. 앰코는 본 문서의 정보사용에 따른 특허나 라이선스 등과 관련된 어떠한 형태의 피해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 문서는 앰코의 제품보증과 관련하여 표준판매약관에 명시된 것 이상으로 확대하거나 변경하지 않습니다. 앰코는 사전고지 없이 수시로 제품 및 제품정보를 변경할 수 있습니다. 앰코의 이름 및 로고는 Amkor Technology, Inc.의 등록상표입니다. 그 외 언급된 모든 상표는 각 해당 회사의 자산입니다. © 2018, Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved. DS613C Rev Date: 10/18

